

# 接合装置

## Bonding System

### EHB-400



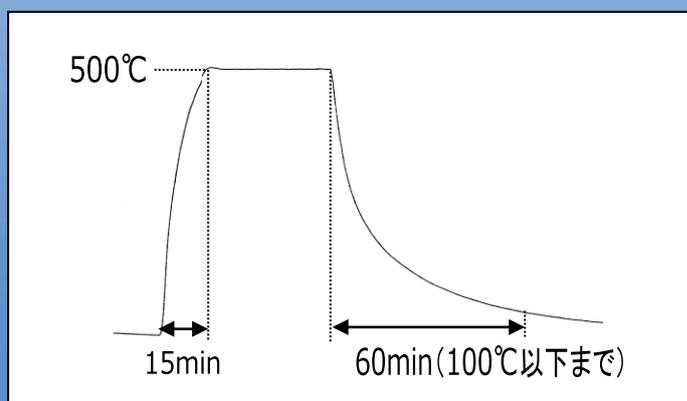
#### → 概要

- ・本装置は、MEMS／センサ／SOIデバイス等の研究開発用接合装置です。
- ・同種／異種材料をウェハレベルで高精度に接合することを目的とし、高真空下での加熱／荷重／基板洗浄／アライメントに対応しています。
- ・独自のマルチスパッタリングシステムとの連結により、多層膜の成膜から接合までを真空中で一貫して処理を行うことも可能です。

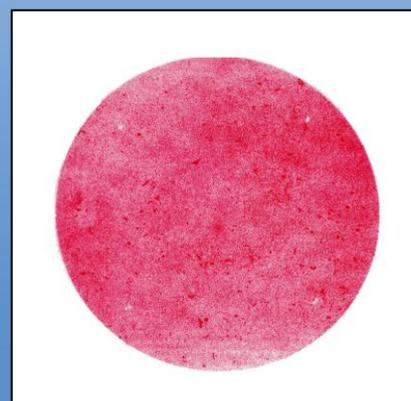
#### → 接合応用例

シリコン-シリコン、シリコン-セラミックス(PZT)、シリコン-ガラス、化合物半導体

#### → 特長



高真空中での温度プロファイル例



荷重分布例

- ・MAX4インチまでのウェハレベルの各種接合に対応します。
- ・独自の加熱荷重機構により温度を正確に制御し、均一な荷重分布で荷重熱処理を行います。